

Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje - PACKNET

Nota de Prensa

www.packnet.es

Encuentros PACKNET con la Innovación

La **Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje** lanza una nueva línea de trabajo denominada “**Encuentros PACKNET con la Innovación**”, que viene a complementar el conjunto de actividades y acciones que en la actualidad viene desarrollando la Plataforma en su calidad de eje vertebrador de la innovación a nivel nacional en el sector del envase y embalaje.

Madrid 07 de septiembre de 2016. Bajo el título “*Inmunidad contra la disrupción*” se presenta el próximo 29 de septiembre este primer Encuentro que - en formato desayuno de trabajo - pretende ser otra herramienta dinamizadora y de generación de conocimiento destinada a los diferentes agentes científicos, tecnológicos y empresariales que integran la propia **Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje -PACKNET**. En esta ocasión, el Encuentro será inaugurado por Dña. M^a Ángeles Ferré - Jefa de la Subdivisión de Programas Temáticos Científicos-Técnicos en la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, y al mismo tiempo contará con la intervención de D. Ricardo Díaz, Profesor de IE Business School y colaborador en distintas instituciones, entre las que destaca el MIT, quien une a su experiencia docente, su labor ayudando a empresas y a directivos a entender las oportunidades que hay en el espacio entre estrategia, tecnología e innovación, y que en este caso expondrá los principales “ingredientes de la receta secreta de la inmunidad” para impulsar y fomentar una masa crítica de innovación dentro de las empresas.

Los “**Encuentros PACKNET con la Innovación**” contarán en sucesivas sesiones con la participación de un amplio abanico de expertos y profesionales contrastados del sector del envase y embalaje, dispuestos a aportar lo mejor de sí y a compartir sus conocimientos con el resto de invitados. Asimismo, pretenden ser un punto de encuentro donde los propios miembros de la Plataforma contribuyan a identificar nuevas oportunidades empresariales y emprender nuevos proyectos a través del *networking* empresarial e intercambio de conocimientos propiciado.

De esta manera, la **Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET** continúa fiel a su objetivo de aunar esfuerzos e impulsar la investigación, el desarrollo y la

investigación del sector del envase y el embalaje. Los **Encuentros PACKNET con la Innovación** vienen a completar aún más si cabe, el conjunto de actividades desarrollados por la propia Plataforma a través de los diversos Grupos de Trabajo tanto Temáticos como Interplataformas, las diversas jornadas prácticas, paneles de expertos, *roadmps*, etc. así como su participación en entidades nacionales e internacionales.

Sobre la **Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET**.

La **Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje - PACKNET** ha sido constituida como un foro abierto de trabajo multidisciplinar liderado por las empresas y las respectivas asociaciones empresariales del sector, contando además con el soporte de centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y profesionales independientes.

El objetivo general de **PACKNET**, es dar una respuesta estratégica conjunta del sector del envase y embalaje y al mismo tiempo, crear un espacio común donde intercambiar conocimientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el sector del *packaging*. Además, **PACKNET** tiene como objetivo prioritario estimular la generación de una masa crítica de I+D+i de carácter interdisciplinar e intersectorial atendiendo prioridades y retos de la sociedad.

Entre los servicios que la **Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET** ofrece, destacan principalmente la organización de grupos de trabajo, jornadas técnicas y sesiones prácticas que – mediante la aplicación de diferentes metodologías (roadmaps, paneles de expertos, etc.) – se desarrollan en torno a diversos temas de interés para el sector del envase y embalaje.

Más información en:

www.packnet.es
comunicacion@packnet.es

ENLACES A MEDIOS

<http://www.retema.es/noticia/packnet-lanza-una-nueva-linea-de-trabajo-encuentros-packnet-con-la-innovacion-6Fd2x>

<https://www.alimarket.es/noticia/221392/packnet-inicia-una-linea-de--encuentros-con-la-innovacion->

<http://profesionaleshoy.es/packaging/2016/09/09/packnet-se-da-cita-con-la-innovacion-en-sus-proximos-encuentros/6028>

<http://www.interempresas.net/Envase/Articulos/161290-Se-convoca-el-primer-Encuentro-Packnet-con-la-Innovacion.html>

<http://www.handling-storage.com/packnet--encuentros-packnet-con-la-innovacion.html>

<http://www.mundoplast.com/noticia/encuentros-packnet-con-innovacion/85045#.V9e1cmi0unl.hootsuite>

<http://ide-e.com/wp/encuentros-packnet-con-la-innovacion/>

<http://www.interempresas.net/Envase/Articulos/161290-Se-convoca-el-primer-Encuentro-Packnet-con-la-Innovacion.html>